

2024年9月25日

日清エンジニアリング 「TOKYO PACK 2024－東京国際包装展－」に出展 ～工場・生産設備のエンジニアリング力をアピール～

日清製粉グループの日清エンジニアリング株式会社（取締役社長：後藤 卓弘）は、本年10月23日（水）～25日（金）の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開催される「TOKYO PACK 2024－東京国際包装展－」に出展します。

■ ブース概要（小間番号：東5ホールC-21）

当社ブースでは、食品や粉体等を取り扱う工場・生産設備のトータルエンジニアリングを提案します。特に、粉体ハンドリング技術として、少量多品種生産に適したバッチ連続システムである「マトコン・コンテナシステム」を紹介します。

《主な出展内容》

■ マトコン・コンテナシステム

粉体用コンテナを用いたバッチ連続システムで、コンタミネーションリスクの低減を可能にし、少量多品種生産に適しています。ブース内ではLEDパネルを用いて構造のイメージや製造フロー例を分かりやすく紹介します。

当社は2002年から英国マトコン社のエンジニアリング・パートナーとして「マトコン・コンテナシステム」をお客様へ導入しており、食品・医薬に加えて、化学、金属粉体や電子・電池材料粉体等、幅広い分野で採用されています。

■ 食品・粉体工場のトータルエンジニアリング

工場建設や生産設備施工のプロジェクトについて、トータルエンジニアリングの視点から、進め方・取り組み方のポイントを紹介します。また当社の工場建設や生産設備施工の実績について、工場写真やミニチュア模型を展示します。



<ブースイメージ>



<マトコン・コンテナシステム>

■ 「TOKYO PACK 2024－東京国際包装展－」概要

TOKYO PACK 2024は、包装資材、包装機械から包材加工機械、食品機械、関連機器類、環境対応機材、物流機器類に至る生産・包装・流通の技術振興をはかるとともに、相談や交流及び包装の最新情報発信の場として、国際的な視野に立った社会の発展に資することを目的とした、世界有数の国際総合包装展です。

- ・開催期間：2024年10月23日（水）～25日（金）
- ・開催時間：10：00～17：00
- ・会場：東京ビッグサイト 東ホール（東京都江東区有明3-11-1）
- ・主催：公益社団法人日本包装技術協会
- ・Webサイト：<https://www.tokyo-pack.jp/>

以上

この件に関する報道関係者のお問い合わせ先
株式会社日清製粉グループ本社 総務本部 広報部 担当：神田・清水
電話：03-5282-6650（お問い合わせフォームは[こちら](#)）